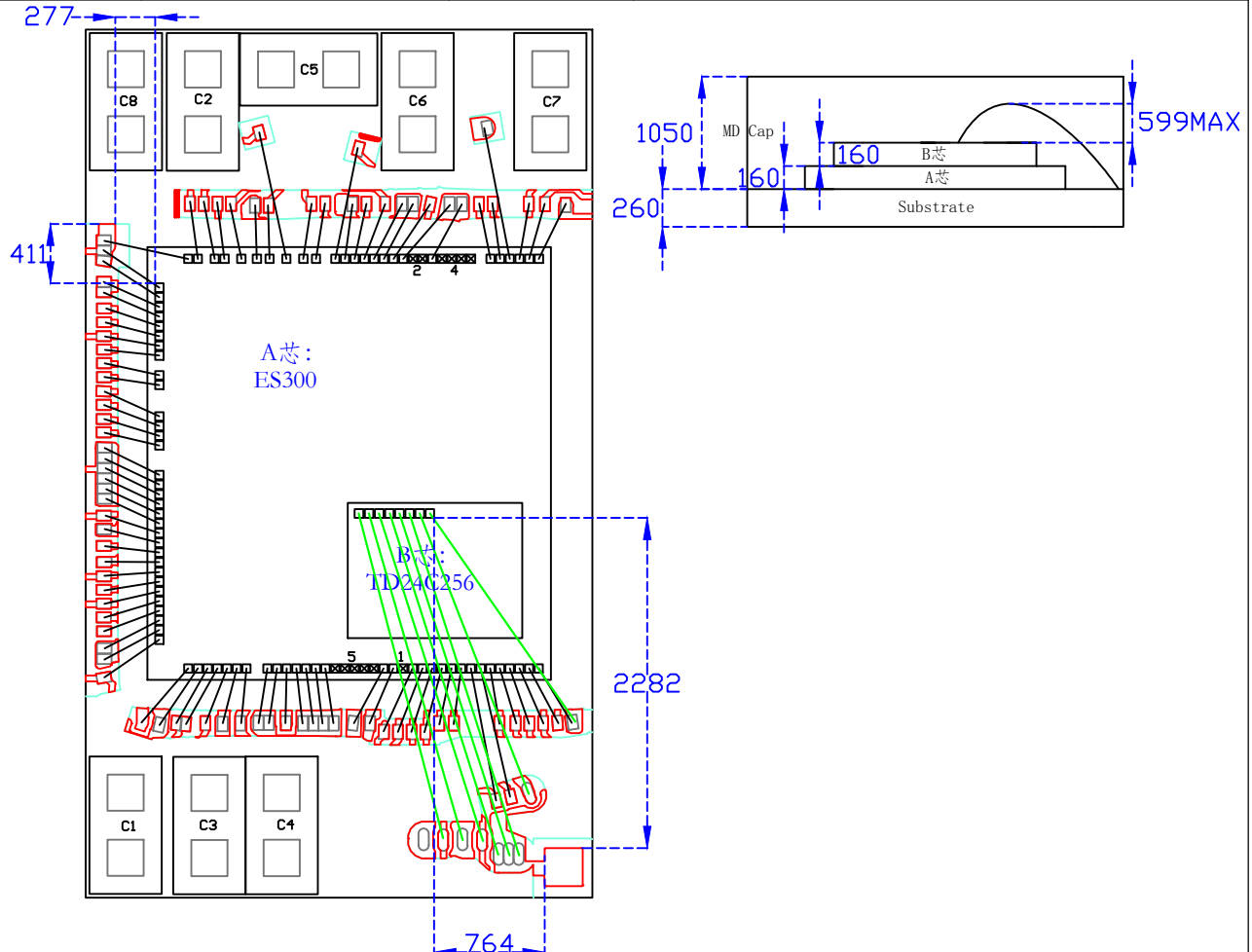
 池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	789	线图号 Drawing No.	HY-PX-789-003 A		
产品名称 Product Type				JS0820LG24		封装外型 PKG Type	LGA24L(3.5X6.0X1.31)		
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		基板编码 Substrate No.	
金丝 Au	18	95	86180	2480	369	首选(Preferred): G760L TypeA 备选(Optional):		LGA24(035060)789002	
剪刀型号 Capillary Type		SF2-25080R-XJM		客户图号 Customer drawing NO.					



1	片式电容 CL03A105MQ3CSNH	CAP, 1U0F, ±20%, 6.3V, X5R, 0201	8	C1~C8
序号	料号	型号规格	数量	位号

框架传送方向(装片):
L/F Direction (D/A):




实物图:
Chip photo:

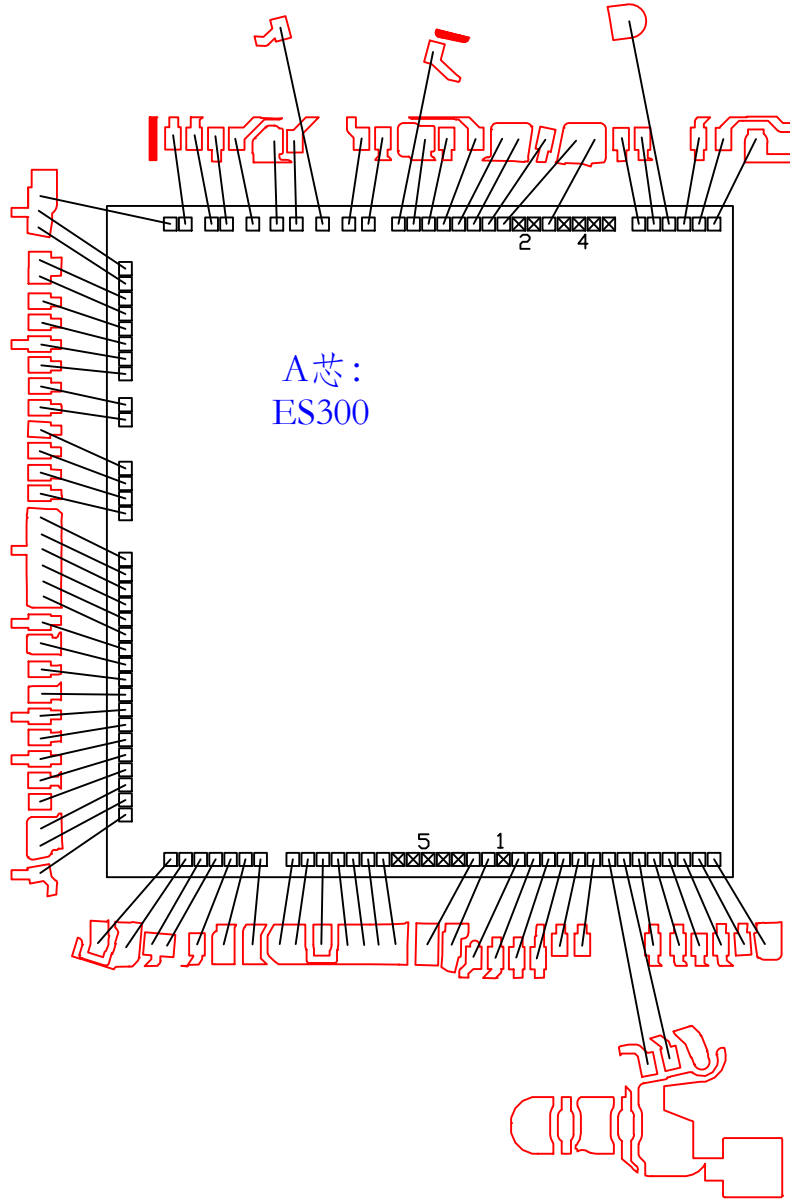
特殊说明 Special Instructions:
DB注意: 装片位置公差为±30um;
WB注意: 数字为不打线PAD点个数。

说明 Instructions	粘片胶类型 epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm²)	最小焊盘间距 Min BPP(μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否是 Low-K If low-k?	减薄厚度 (μm) Wafer Thickness
A芯: DIE A	绝缘胶 (Non-conductive) 2025DSI	ES300	2790*2990(μm²) 109.84*117.71(mil²)	59*57	67	0.9	是/Yes	60	8	是/Yes (130nm)	160
B芯: DIE B	绝缘胶(DAIF) (Non-conductive) HR-5104	TD24C256	1204*934(μm²) 47.40*36.77(mil²)	60*60	70	1.2	是/Yes	60	8	否/NO	160

制图日期 Create Date	2022/10/14		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature	
拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approved by			


*温馨提示: 图纸为产品下线生产的唯一依据, 请您认真确认, 我司依据您回签后的图纸生产, 如图纸错误会产生不可估量损失, 谢谢!
 *warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce incalculable loss. Thank you

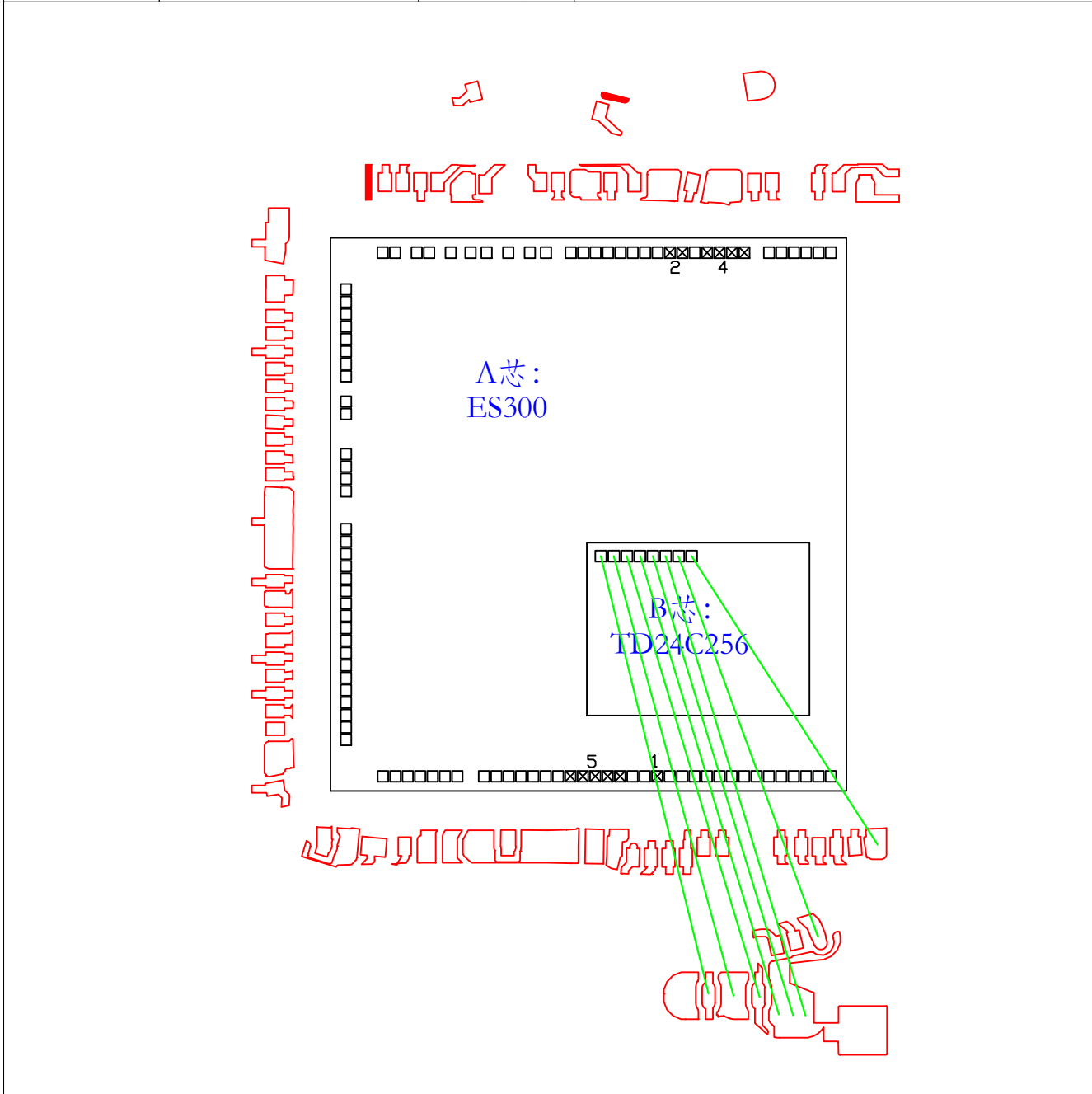
 池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	789	线图号 Drawing No.	HY-PX-789-003 A	
				产品名称 Product Type	JS0820LG24		封装外型 PKG Type	LGA24L(3.5X6.0X1.31)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		基板编码 Substrate No.
金丝 Au	18	87	65096	929	369	首选(Preferred): G760L TypeA 备选(Optional):		LGA24(035060)789002
劈刀型号 Capillary Type		SF2-25080R-XJM		客户图号 Customer drawing NO.				



实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions : DB注意: 装片位置公差为±30um; WB注意: 数字为不打线PAD点个数。
---------------------	---

制图日期 Create Date	2022/10/14	生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature	
拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approved by		

 池州华宇电子科技股份有限公司 CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 焊线图纸 Bonding Diagram				客户代码 Customer No.	789	线图号 Drawing No.	HY-PX-789-003 A	
				产品名称 Product Type	JS0820LG24		封装外型 PKG Type	LGA24L(3.5X6.0X1.31)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		基板编码 Substrate No.
金丝 Au	18	8	22003	2480	1854	首选(Preferred): G760L TypeA 备选(Optional):		LGA24(035060)789002
劈刀型号 Capillary Type		SF2-25080R-XJM		客户图号 Customer drawing NO.				



实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions : DB注意: 装片位置公差为±30um; WB注意: 数字为不打线PAD点个数。
---------------------	---

制图日期 Create Date	2022/10/14	生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature	
拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approved by		